

製品仕様書

RSD-SUNMAX-PSE5050（ピコ秒レーザー ガラス切断機）

1. 概要

RSD-SUNMAX-PSE5050 は、ガラスをレーザーで高速・高精度に切断するためのピコ秒レーザー加工機です。ワークエリアは 500 × 500mm で、用途に応じてカスタム（最大 1200 × 1200）も可能です。

2. 主な特長

- ワークエリア 500 × 500mm（カスタム最大 1200 × 1200）
- ガルバノ・高精度 CCD 視覚位置決めにより高精度加工（構成により異なります）
- 水冷方式・レーザー出力 10～80W（用途に応じて選定）
- ガラス厚み 0.01～50mm に対応（材質・条件により異なります）／CO2 分割レーザー対応（オプション/構成による）

3. 製品仕様

項目	仕様
型式	RSD-SUNMAX-PSE5050
レーザー形式	ピコ秒レーザー（IR/赤外線） + CO2（分割用）
レーザー出力[W]	10 ～ 80
波長	1064 [nm]（IR）
ワークエリア[mm]	500 × 500（カスタム最大 1200 × 1200）
加工可能素材厚	0.01 ～ 50 [mm]
冷却方式	水冷
切断速度	400 [mm/s]
電源	AC220 V
外寸：幅 × 奥行 [mm]	1500 × 1620（高さ要確認）

4. 設置条件・必要設備（抜粋）

- 設置スペース：本体外寸に対して、前後左右それぞれ最低 1.5 m 以上の空きスペースが必要
- 電源：AC220V/50Hz/60Hz/60A（設備条件により変圧器等が必要な場合があります）

5. 推奨オプション（抜粋）

品名	型式	用途/備考
自動水冷機（チラー）	要確認	レーザー・光学系の冷却（出力/構成により型式が異なります）
排気装置／集塵機	要確認	加工時の煙・粉塵の排出/捕集（必要に応じて）
保護メガネ	-	レーザー安全対策（波長・クラスに適合するもの）

6. 注意事項

- ・本機はレーザークラス4 機器です。保護具の着用、管理区域の設定、反射物・可燃物の管理など、レーザー安全運用を徹底してください。
- ・仕様・外観は改良等のため予告なく変更される場合があります。最終仕様は見積書/受領仕様書にてご確認ください。

7. 構成（例）

- レーザー加工機本体
- 制御用パソコン／操作パネル（付属構成は仕様により異なります）
- 自動水冷機（チラー）
- 排気装置／集塵機（仕様・運用により異なります）
- 電源ケーブル／基本工具類（構成は納入仕様により異なる場合があります）

8. 保守・消耗品（参考）

- ノズル・保護レンズ・セラミックリング・フィルタ等は消耗品です。運用条件に応じて定期点検／交換を推奨します。
- 消耗品の型式・交換周期は、材質・粉塵量・加工時間等により変動します。

9. 免責

本書記載の仕様・外観は改良等のため予告なく変更される場合があります。最終仕様は、見積書／受領仕様書にてご確認ください。